آوهش فيريك

مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۹، شمارهٔ ۱، بهار ۱۳۸۸ مقالهنامهٔ اولین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی، خرداد ۱۳۸۷

$YBa_2Cu_{3-x}M_xO_y$ (M = Ag, Al) خواص ساختاری و ابررسانایی نمونههای

سمیه فلاحتی، فاطمه صائب و وحید دادمهر

آزمایشگاه پژوهشی مغناطیس و ابررسانایی، دانشکدهٔ علوم پایه، دانشگاه الزهرا، کدپستی ۱۹۹۳۸۹۱۱۷۶، تهران، ایران پست الکترونیکی: <u>daadmehr@alzahra.ac.ir</u>

چکیدہ

واژه های کلیدی ابررسانای YBCO، آلایش نفره و آلومینیوم، سل - ژل، ارتباطات ضعیف

۱. مقدمه

پس از کشف ترکیب ابررسانای YBa₂Cu₃O_y جانشینی عناصر مختلف در جایگاههای اتمی متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. آلایش در ترکیب YBCO به دو دلیل صورت می گیرد: اولی تبیین خواص ابررسانایی ترکیب و دومی بهبود مشخصههای فیزیکی و بافت دانهای است. به طور معمول در اولی جانشینی شیمیایی و در مورد دوم اضافه کردن فلز ناخالصی به سرامیک YBCO مورد استفاده قرار می گیرد[1]. از آنجاکه دو جایگاه اتمی مختلف Cu در ترکیب YBCO وجود دارد، اتم مس در زنجیره ما ((1)) و اتم مس در صفحات دارد، اتم می در جایگاه un بسته به اینکه اتم آلاینده کدام جایگاه را اشغال می کند، منجر به خواص جالب و متفاوتی می شود.

در ایسن تحقیسی انسر جانسشینی نقره و آلومینیسوم در ترکیب (M = Ag, Al را مسورد مطالعه YBa₂Cu_{3-x} M_xO_y (M = Ag, Al را مسورد مطالعه قرار میدهیم. انتخاب نقره به این دلیل است که به عنوان یک عامل مؤثر در افزایش دمای گذار و رشد و جهت گیری دانهای معرفی شده است [۲، ۳ و ۴]. در این تحقیق روش سل - ژل را بر اساس نتایج تحقیقات قبلی برای ساخت نمونه ها انتخاب کردیم [۵].

۲. جزئيات تجربي

برای بررسی اثرات جانـشینی M=Ag, Al) M /Cu در سـاختار (M=Ag, Al) در ساختار $YBa_2Cu_{3-x}Ag_xO_y$ بـا مقـادیر آلایـش YBa_2Cu_{3-x}Al_xO_y مراب x = 0.01 (0.01×10^{-7}) (0.01×1

با مقادیر آلایش x =0,0/01,0/02,0/03,0/045 به روش سل -ژل ساخته شدهاند [۶ و ۷]. آنالیز فازی نمونه ها بوسیله الگوی پراش اشعه - X (XRD, Philips Cu kα radiation) پودری تعیین می گردد. ریز ساختار با میکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین می گردد. ریز ساختار با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM, Philips XL30) میشاهده و مقاومت الکتریکی با استفاده از تکنیک چهار میله ای استاندارد برای ۲۰۰۳-۷۷

۳. بحث و نتیجه گیری

خلوص فاز نمونهها بـ کمـک أنـاليز XRD پـودري مـشخص شـــدهانـــد. شـــكل(۱) الگوهـــاي XRD نمونـــههــاي با مقادير تراكم آلايـــش YBa₂Cu_{3-x}Ag_xO_v x =0,0/1,0/15,0/2,0/3 را نـشان مـيدهـد. از مقايـسه ايـن طیفها با کارتهای JCPDS می بینیم که فاز ۱۲۳ به همراه پیکهای مربوطه در زوایای مختلف در همه نمونهها تشکیل شـده اسـت. ارتفاع پیک اصلی این نمونه ها در 2q = 34/87^o است که مربوط به صفحه (۳۱) میباشد. الگوهای پراش نمونه خالص و نمونے ہےای YBa₂Cu_{3-x} Ag_xO_v بےا مقادیر آلایے ش x =0/1,0/15,0/2 هـيچ پيک ناخالـصي ندارنـد، بنـابراين جانشینی Ag/Cu به خوبی و به طور کامل انجام شده و هیچ فاز ناخالصی در طول انجام فرآیند شکل نگرفته است. الگوی پراش XRD نمونه با 3 /x =0 پیکهای خیلی ناچیزی از Ag را نشان میدهد، در نتیجه مقدار اضافی آلایش Ag در ساختار ۱۲۳ وارد نشده و در بین دانهها باقی مانده است و نقش تقویت ارتباطات ضعيف را بازی خواهد كرد. شكل (۲) الكوهای XRD نمونههای YBa₂Cu_{3-x}Al_xO_y را نشان میدهد.الگوهای پراش نمونیه خالص و نمونیههای YBa₂Cu_{3-x}Al_xO_y با مقادیر آلايش x =0/01,0/02 هيچ پيک ناخالصي ندارند.

الگوی پراش XRD نمونه با آلایش x =0/03 پیکهای خیلی ناچیزی از Y2BaCuO₅ را نشان میدهد که با افزایش مقدار آلایش در x =0/045 شدت این پیکها کمی افزایش یافته است.

ثابتهای شبکه و مکانهای اتمی نمونهها بدست امده از

نرمافزار MAUD و مقدار اکسیژن(y) اندازه گیری شده به روش یدومتری در جدول(۱) آمده است.

با افزایش میزان آلایش، تغییرات قابل توجهی در پارامترهای شبکه دیده نمی شود. عدم تغییر در اشغال محل (2)Cu، کاهش کسر اشغال محل (1)Cu و افزایش کسر اشغال Ag و Al در جایگاه (1)Cu متناسب با افزایش مقدار آلاینده، نشان میدهند که جانشینی ها در جایگاه (1)Cu انجام شده است. درجه اورترومبیسیتی نمونه های VBa₂Cu_{3-x}Al_xOy از ۸۴/۰ در نمونه خالص به ۵۹/۰ در نمونه با آلایش ۴۵/۰ کاهش مییابد.

شکل ۳ نتایج اندازه گیری مقاومت الکتریکی بر حسب دما و تراکم آلایش را برای نمونه های γBa₂Cu_{3-x}Ag_xO_y نشان می دهد. مقاومت حالت نرمال برای همه نمونه ها، رفتار فلزی داشته و شیب آن مثبت است. دمای گذار نمونه ها با افزایش مقدار آلایش gA تا 20/15 x افزایش یافته و برای مقادیر بالاتر آلایش کاهش می یابد. همان طور که می بینیم دمای گذار با آلایش gA افزایش یافته که مؤید کارهای ام. تپه و اُ. گورور است [۲ و ۸]. علاوه بر این ثابت ماندن تقریبی TC با افزایش است [۲ و ۸]. علاوه بر این ثابت ماندن تقریبی متC با افزایش ناخالصی خاصی را ایجاد نکرده است. بهینه مقدار آلایش مع در ساختار ۲۲۳ مقدار گارات x معرفی شده که حداکثر دمای گذار را ارائه می دهد. M. Tepe یا یونهای مقاومت الکتریکی بر گذار را ارائه می دهد. YBa₂Cu_{3-x}Al_xO_y

مقاومت حالت نرمال برای همه نمونهها، رفتار فلزی داشته و شیب آن مثبت است و با افزایش مقدار آلایش IA افزایش مییابد و مؤید کار آر وی ووک و همکاران [۹] است. دمای گذار نمونهها با افزایش آلایش IA به طور یکروند کاهش مییابد روند کاهش دمای گذار ابررسانایی با آلایش IA در جانشینی Al/Cu نتایج کارهای تی سیگریست [۱۰] و تار اسکن [۱۱] را تأیید میکند بدلیل محدودیت اندازه گیری دمای گذار دستیابی به مقادیر پایینتر Tc ممکن نبود پهنای گذار



شکل۱. الگوی پراش اشعه X نمونههای YBa₂Cu_{3-x}Ag_xO_y برای مقادیر آلایش x =0,0/1,0/15,0/2,0/3



جدول ۱. ثابتهای شبکه و درصد اشغال مکانهای اتمی و مقدار اکسیژن در نمونههای (M = Ag, Al) YBa₂Cu_{3-x}M_xO_y (M = Ag, Al)

ابررسانایی با افزایش جانشینی Al/Cu افزایش یافته است. کاهش دمای گذار ابررسانش با آلایش IA را می توان به جانشینی آن در زنجیرههای اتمی Cu-O نسبت داد. از آنجا که ⁴⁴ Al یک یون سه ظرفیتی است با جانشینی در زنجیرههای اتمی، اکسیژن بیشتری را به سمت زنجیرهها جابه جا می کند، بنابراین حفرهها در زنجیره ها جایگزیده می شود [۱۲ و ۱۴]. بنابراین یونهای ^{۲+} Al بر جفت شدگی و انتقال بارها اثر

می گذارند.

شکل ۵ تصاویر SEM نمونههای YBa₂Cu_{3-x}Ag_xO_y را نشان میدهد که در آنها همگنی دانهها با آلایش نقره افزایش یافته و ارتباطات قویتری بین دانهها برقرار شده است. این در توافق با کار سی. لبینوند - هارنویز و همکارانش است، که نشان دادند با آلایش نقره تخلخل نمونه کاهش یافته و ساختاری تقریباً عاری از هرگونه شکاف و حفره به دست



آلایش x =0-0/045 شکل داخلی جزئیات گذار را نشان میدهد.



شکل۵ تصاویر SEM نمونههای VBa₂Cu_{3-x}Ag_xO_v

می آید [۴]. بنابراین انتظار داریم که آلایش نقره به افزایش J_c کمک کند. مقالات زیادی افزایش J_c در اثر آلایش Ag را گزارش کردند که افزایش سطح تماس دانهها، تغییر در مرزهای بین دانهای و رشد و جهت گیری مناسب دانهها را علل اصلی افزایش چگالی جریان بحرانی با افزایش آلایش Ag معرفی کردند [۲، ۳، ۱۵ و ۱۹].

x =0-0/3 شكل داخلي جزئيات گذار را نشان مي دهد.

تصاویر SEM در شکل ۵ نشان می دهد که با افزایش مقدار آلایش نقره تا x =0/15 دانه ها رشد بهتری کرده اند، اما با آلایش اضافی نقره در x =0/3 دانه ها ریزتر شده اند. در نتیجه افزایش مقدار آلایش از حد بهینه به عنوان یک عامل بازدارنده

از رشد و جهـتگیـری دانـهای عمـل مـیکنـد کـه کـاملاً کـار ام. تپه و همکارانش را تأیید میکند[۲].

۴. نتايج

اثر آلایت شنقره و آلومینیوم در نمونههای ابررسانای ابررسانای (مده تقرم و آلومینیوم در نمونههای ابررسانای (مده شده YBa₂Cu_{3-x} M_xO_y (M = Ag, Al) مورد مطالعه قرار داده شده است. تصاویر SEM نمونههای $yBa_2Cu_{3-x}Ag_xO_y$ نشان می دهد که همگنی و سطح تماس دانهها با آلایش نقره افزایش یافته و ارتباطات قویتری بین دانهها برقرار شده است. مقدار بهینه جانشینیها در جایگاه (1) انجام شده است.

میشویم. افزایش جایگزیدگی حفرهای در اثـر جانـشینیAl/Cu در صفحات ۲۵ می تواند یکی از علل کاهش T_c باشد.

قدردانی نویسندگان از حمایت مالی معاونت پژوهـشی دانـشگاه الزهـرا تشکر میکنند.

- 11. J M Tarascon, P Barboux, P F Miceli, L H Greene and G W Hull, *Phys. Rev.* B **37** (1988) 13.
- 12. M D Glinchuk and A P Pechenyi, Ferroelectrics, **155** (1994) 25-30.
- 13. Pinglin Li, Jincang Zhang, Guixin Cao, Chao Jing, and Shixun Cao, *Phys. Rev.* B **69** (2004) 224517.
- 14. S Schmenn, H. Lutgemeier, Th Wolf and E Brecht, Journal of LOW Temprature Physics, **105** (3-4) (1996) 425-430.
- 15. M J Qin, A W Kaiser and H J Bornemann, Physica C **311** (1999) 280–286.
- 16. E Mendoza, T Puig, E Varesi, A E Carrillo, J Plain and X Obradors, *Physica* C **334** (2000) 7–14.
- 17. C Harnois, G Desgardin, I Laffez, X Chaud and D Bourgault, *Physica* C **383**(2002) 269–278.
- 18. J Jung, I Isaac and M A-K Mohamed, *Phys. Rev.* B 49(1993)10.
- 19. C H Cheng and Y Zhao, *Physica* C **463–465** (2007) 174.

آلایش نقره ۱۵/۰ به دست آمد. افـزایش مقـدار آلایـش از حـد بهینه به عنوان یک عامل بازدارنده از رشد و جهتگیری دانـهای عمل میکند.

اندازهگیری مقاومت الکتریکی برحسب دما برای مقادیر کـم آلایش AI کاهش جزیی در دمای گذار را نشان میدهـد امـا بـا افزایش مقدار آلایش با افت سریع در دمای گذار (۰)T مواجـه

مراجع

- J M S Skakle, Materials Science and Engineering, R23 (1998)1-40.
- M Tepe, I Avci, H. Kocoglu and D Abukay, Solid State Communications 131 (2004) 319–323.
- 3. G Bolaflos and P Prieto, Physica C 341-348 (2000) 1197.
- 4. C Lebiond-Harnois et al., *Physica* C, **341-348** (2000) 2439.
- 5. S Barekat Rezaee, V Daadmehr, and S. Dadras, *Fifth International Conference* MSM (2007) 93.
- 6. S Barekat Rezaee, V Daadmehr, F Saeb and S Falahati, *Fifth International Conference* MSM 31 (2007).
- R S Liu, W N Wang, C T Chang and P T Wu, Jpn. J. Appl. Phys. 28 (1989) L2155-L2157.
- O Gorur, T Kucukomeroglu, C Terzioglu, A Varilci and M Altunbas, *Physica* C 418 (2005) 35.
- 9. R V Vovk, et al., Journal of Materials Science; Materials in Electronics, **18** (2007)811-815.
- T Siegrist, L F Schneemeyer, J V Waszczak, N P Singh, R L Opila, B. Batlogg, L W Rupp and D W Murphy, *Phys. Rev.* B 36(1987)316.